

BUNGARD PICK&PLACE SMT3000

Manipulator für die Fertigung von Prototypen und kleinen Serien. Der patentierte Pick & Place-Kopf ermöglicht das bequeme Handling von SMD-Bauteilen. Das modulare System kann für jeglichen Einsatz konfiguriert werden. Das System realisiert den gesamten Prozess vom Aufbringen der Lotpaste oder Kleber bis zum Bestücken der verschiedenen Bauteile.

Eigenschaften:

- Ergonomisch
- Integrierte Dosiereinrichtung
- Kameraaufsatz
- X/Y-Feststellung
- Kopfbeleuchtung
- Leiterplatten-Halter
- Tischgerät
- hochwertige Verarbeitung

Kameraaufsatz

Mittels einer direkt am Bestückkopf adaptierbaren Kamera kann der gesamte Bestückvorgang, vom Abholen bis zum Platzieren des Bauteils, auf einem Monitor vergrößert dargestellt werden.

X/Y-Feststellung

Für genauestes Bestücken sorgt die X/Y-Feststellereinrichtung. Einzelne Bewegungsachsen können gesperrt werden. Eine Automatikfunktion sperrt selbständig die X- und Y-Achsen beim Absetzen der Bauteile bzw. beim Setzen eines Dosierpunktes. Dies erleichtert insbesondere das Absetzen von Melfs.

Kopfbeleuchtung

Die Dual-LED-Beleuchtung des Entnahme- bzw. Bestückungsbereichs kann optional am Bestückungskopf integriert werden. Die LEDs sitzen beidseitig der Bestückungsnozzle und sorgen somit für eine gleichmäßige und dauerhafte Ausleuchtung unterhalb des Bestückungskopfes.

Die Integration in die Steuerung des Manipulators erlaubt die menügeführte Aktivierung und Leuchtstärkenregulierung der Beleuchtung – je nach Anwendungsfall.



Leiterplatten-Halter

Alle Manipulatoren verfügen standardmäßig über eine universelle Leiterplatten-Schnellspannvorrichtung für ein- und zweiseitige Leiterplatten. Die federnden Aufnahmeöffnungen sind verstellbar und fixieren die Platte. Große Leiterplatten können bei Bedarf unterstützt werden; kundenspezifische Aufnahmen können angepasst werden oder sind direkt in unserem Hause realisierbar.

SMT 3000

Bestückleistung:	300-600 SMDs/Stunde
Abmessungen (LxBxH):	600 x 600 x 345 mm
Max. Ausladung (LxBxH):	600 x 1100 x 345 mm
Max. Leiterplattengröße (LxB):	440 x 245 mm
Max. Bestückbereich (LxB):	350 x 245 mm
Max. Bestückbereich (LxB):	350 x 245 mm
Leiterplattendicke:	0,5 mm bis ~ 4 mm
Höhe unterhalb der Leiterplatte:	min. 39 mm, max. 50 mm
Bauteile:	Chip 0201 bis QFP 0,65 mm pitch
Max. Bauteilhöhe:	ca. 16 mm
Hub des Bestückkopfes:	max. 26 mm
Drehwinkel:	0-360°
Gewicht:	ca. 23 kg
Netzspannung:	100- 230 V AC, automatisch
Leistungsaufnahme:	max. 50 VA

(Nur bei Dosiereinrichtung):

Saubere, ölfreie Druckluft, max. 4 bar,
1,5 l/min Verbrauch während des Dispensens
Druckanschluss für Schlauch iØ 4 mm, aØ 6 mm



BAUTEILZUBRINGER

Die Bauteile können sowohl im Gurt, als auch als Schüttgut an dem System zur Verarbeitung bereitgestellt werden.



Drehteller

Der antistatische Drehteller mit 45 Fächern befördert in komfortabler Weise Bauteile als Schüttgut.



Tapefeeder

Tapefeeder können Standardbauteile in großen Mengen am Arbeitsplatz bevorraten. Beim Abziehen des Deckbandes wird der Gurt automatisch vorgeschoben und die zu verarbeitenden Bauteile freigelegt.



Laborgurtspender

Mit dem Laborgurtspender können die für die Produktion benötigten Gurtabschnitte verarbeitet werden. Die einzelnen Bauteile können direkt aus dem Gurt entnommen werden und es entfällt das Umfüllen in Schüttgutbehälter.



Schüttgutbehälter

Der patentierte Schüttgutbehälter stellt am Manipulator Kondensatoren, Widerstände und ICs aus kleinen Trays zur Verfügung.



HOTAIR 06

REFLOW OFEN

Der HotAir06 ist ein Lötoven für SMD-Bauteile bei Einsatz von bleifreier Lötpaste.

Der Ofen arbeitet während der Vorheizphase mit zwangsgeführter Heißluft. In der Reflow-Phase schaltet sich die Quarzheizung zu, um mit einer kurzen Rampe auf die Löttemperatur zu kommen.

Sobald der Sollwert der Reflow-Temperatur erreicht ist, wird die Lampenleistung auf ein Minimum reduziert. Zu diesem Zeitpunkt wird 85% der Heizleistung durch die Heißluftheizung erbracht. Diese einzigartige Funktion macht den HotAir06 geeignet für große SMD-Bauteile und Komponenten mit Lötstellen auf der Gehäuseunterseite und das sogar bei Benutzung bleifreier Lötpaste.

Bei guter Wartung und richtigem Gebrauch wird der Ofen alle Ihre Lötünsche lange erfüllen und Lötergebnisse in perfekter Qualität erzielen.



Einige besondere Merkmale:

- Ausgezeichnete Qualität des Reflow Lötens von SMD und Hybrid Schaltungen
- Heißluft Quarz Ofen für Lötpasten und SMD Kleber
- Zwei Heizzonen
- leicht programmierbare Mikroprozessorsteuerung
- Sichtkontrolle des Reflowprozesses

HOTAIR 06

Stromanschluss:	208/240 V, 1 Phase 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 3650 W
Abmessungen (LxBxH):	550 x 490 x 335 mm
Max. Substratgröße:	300 mm x 370 mm
Zahl der Heizzonen:	2 Stück, beide über Mikroprozessor gesteuert
Vorheizzeit:	0-999 Sekunden
Vorheiztemperatur:	60-260°C
Reflow Zeit:	0-999 Sekunden
Reflow Temperatur:	90-300°C
Aufheizzeit bis zur therm. Stabilisierung:	ca. 8 Minuten
Nettogewicht:	18 kg
geplante Optionen:	Stickstoffanschluss mit Durchflussmesser